

# シンタリングペースト

低温焼結の樹脂分散型銀シンタリングペーストは、高熱伝導、低抵抗を実現します。

- 低温金属結合 200°C/1.5h
- 高熱伝導率 200w/mk
- 低体積抵抗  $5.0 \times 10^{-6} \Omega \cdot \text{cm}$

項目	単位	高温鉛半田 Pb95/Sn5	シンタリングペースト ご提案品A	条件
粘度 (25°C)	Pa · s	-	100	3°cone 0.5min <sup>-1</sup>
熱伝導率	W/mk	32	200	レーザー フラッシュ法
体積抵抗率	ohm.cm	-	$4.1 \times 10^{-6}$	室温
弾性率	25°C	16.0	21.6	DMA
	260°C			
CTE	ppm/°C	29	20	TMA
硬化条件	-	-	200°C/1.5h	無加圧、エア

項目	単位	銀ペースト 従来品	シンタリングペースト ご提案品B	条件
粘度 (25°C)	Pa · s	10	8	3°cone 0.5min <sup>-1</sup>
チクソ	-	3.0	3.0	0.5/5.0min <sup>-1</sup>
体積抵抗率	ohm.cm	$50 \times 10^{-6}$	$5.0 \times 10^{-6}$	室温
せん断強度	N	28	30	25°C
硬化条件	-	200°C/1.5h	200°C/1.5h	無加圧、エア

